

第5回

3次元積層 半導体量子イメージセンサ 研究会

KEK

AIST

東京
大学

筑波
大学

2021.2.24 (水) 13:30-17:15

会場：WEBEX によるリモート開催

※申し込みされた方には後日ご招待のメールを送付致します。

招待
講演

表面活性化による異種半導体直接接合界面の
電気特性と太陽電池応用
大阪市立大学 重川 直輝

異種半導体材料の積層化およびデバイス集積化技術
産業技術総合研究所 前田 辰郎

●一般講演：

東京大学 高松 誠一、産業技術総合研究所 松前 貴司

参加
申込



会場準備の都合上、できるだけ事前申込みをお願いします。
詳細はサイトをご覧ください。

https://rd.kek.jp/project/soi/TIA21/2102_TIA3D.html

お問
合せ

高エネルギー加速器研究機構(KEK)
先端加速器推進部 倉知郁生 mail: kurachii@post.kek.jp

主催：TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」：「究極の広帯域量子イメージセンサ実現を目指して」グループ
(高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所、東京大学、筑波大学)

後援：TIA、TIA光・量子計測マネージメント・グループ、SOI量子イメージセンサ・コンソーシアム





第5回

3次元積層半導体

量子イメージセンサ研究会

PROGRAM

13:30 はじめに

高エネルギー加速器研究機構 倉知 郁生

一般講演

13:50 量子イメージセンサに向けた薄型 MEMS デバイスの実装技術

東京大学 高松 誠一

一般講演

14:30 表面活性化常温接合を用いたデバイス基板 / 放熱基板の直接接合

産業技術総合研究所 松前 貴司

15:10

Coffee Break

招待講演

15:30 表面活性化法による異種半導体直接接合界面の電気特性と太陽電池応用

大阪市立大学 重川 直輝

招待講演

16:10 異種半導体材料の積層化およびデバイス集積化技術

産業技術総合研究所 前田 辰郎

16:50 ディスカッション & おわりに

17:15 終了

(各講演時間には5分の質問時間を含みます)